

<<电子工艺实训教材>>

图书基本信息

书名：<<电子工艺实训教材>>

13位ISBN编号：9787030124104

10位ISBN编号：7030124103

出版时间：2004-1

出版时间：科学出版社

作者：张翠霞 等著

页数：167

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子工艺实训教材>>

内容概要

《电子工艺实训教材》共分九章，以电子产品整机制造工艺为主线。介绍了焊接工艺知识与焊接技能、电子元器件的识别与检测、整机工艺设计与整机装配、表面贴装技术、常用电子仪器的使用、识图常识、电子技术文件、印制板制作技术简介、电路原理图与印制电路板设计技术。

通过该书的学习，能够帮助读者掌握电子产品制作、生产的基本技能，了解电子产品先进的生产工艺、生产手段。

《电子工艺实训教材》可作为高等院校电子信息类专业的电子工艺实训教材或教学参考书，同时也可供职业教育、技术培训及有关技术人员参考。

《电子工艺实训教材》同时是信息产业部“CEAC国家信息化培训认证管理办公室”电子工程师认证课程体系的指定教材。

书籍目录

第1章 焊接工艺知识与焊接技能1.1 焊接工艺知识1.1.1 焊接的基本知识1.1.2 常用焊接工具——电烙铁1.1.3 常用焊接材料1.1.4 常用线材与绝缘材料1.2 焊接技能1.2.1 焊前准备1.2.2 手工焊接技术1.2.3 工业生产中的焊接简介1.2.4 焊接训练内容第2章 电子元器件的识别与检测2.1 电子元器件知识要求2.2 电阻器2.2.1 电阻的分类及命名方法2.2.2 电阻的主要参数2.2.3 电阻的选用2.2.4 特殊电阻元件2.3 电位器2.3.1 电位器的分类2.3.2 电位器的命名方法2.3.3 电位器的选用2.3.4 电位器的质量检查2.4 电容器2.4.1 电容器的分类及命名方法2.4.2 电容器的主要参数2.4.3 电容器的选用2.4.4 电容器的质量检验2.5 电感器2.5.1 电感器的种类及命名方法2.5.2 电感器的型号表示方法2.5.3 电感的主要参数2.5.4 电感器的识别及质量判断2.5.5 电感器使用注意2.6 开关及接插件2.6.1 开关及接插件的种类2.6.2 开关及接插件的选用2.7 半导体器件2.7.1 半导体器件的分类2.7.2 中国半导体器件型号命名方法2.7.3 日本半导体型号命名方法2.7.4 欧洲半导体分立器件型号命名法2.7.5 美国半导体分立器件型号命名法2.7.6 常用半导体分立器件外形封装及引脚排列2.8 晶体二极管2.8.1 晶体二极管的分类2.8.2 晶体二极管的主要参数2.8.3 晶体二极管的质量检验2.8.4 二极管的使用注意事项2.9 晶体三极管2.9.1 晶体三极管的分类2.9.2 晶体三极管的主要参数2.9.3 三极管的质量检测2.9.4 三极管使用注意事项2.10 场效应晶体管2.10.1 场效应管的分类2.10.2 场效应管的主要参数2.10.3 场效应管的型号2.10.4 场效应管的选用2.10.5 场效应管的质量检测2.10.6 场效应管的使用注意事项2.11 半导体集成电路2.11.1 半导体集成电路的分类2.11.2 集成电路的型号及命名2.11.3 集成电路的引脚识别2.11.4 集成电路质量好坏的估测2.11.5 使用集成电路的注意事项第3章 整机工艺设计与整机装配3.1 整机工艺设计3.1.1 结构设计3.1.2 环境保护设计3.1.3 外观及装璜设计3.2 整机装配的一般步骤和要求3.2.1 机械装配步骤3.2.2 部件装配第4章 表面贴装技术4.1 表面贴装元器件4.1.1 片状电阻器4.1.2 表面贴装电容器4.1.3 其他表面贴装元件及参数4.1.4 表面贴装半导体器件4.2 表面贴装技术简介4.2.1 表面贴装印制板4.2.2 表面贴装工艺4.2.3 表面贴装设备第5章 常用电子仪器的使用5.1 测量误差的基本概念5.1.1 测量误差的主要来源5.1.2 误差的性质与分类5.2 常用电子仪表、仪器的使用5.2.1 万用表5.2.2 低频信号发生器5.2.3 高频信号发生器5.2.4 毫伏表5.2.5 扫频仪5.2.6 数字式频率计5.2.7 双踪示波器第6章 识图常识6.1 电器工程图的种类6.2 识图要求与方法6.2.1 识图要求6.2.2 识图方法6.3 根据整机画电路图第7章 电子技术文件7.1 本章要求7.1.1 共同语言7.1.2 科学作风7.1.3 应变能力7.2 分类及特点7.3 产品技术文件7.3.1 产品技术文件特点7.3.2 工艺文件第8章 印制电路板制作技术简介8.1 印制板的选择8.1.1 印制电路板的类型8.1.2 印制电路板的材料8.1.3 印制电路板的参数及选择8.2 印制电路板的印制8.2.1 光敏抗蚀剂法8.2.2 丝网漏印法8.3 印制板的化学刻蚀8.4 印制电路板的机械加工8.4.1 落料8.4.2 钻孔8.5 铜导体表面的清洗和保护8.6 双面及多层印制电路板第9章 电路原理图与印制电路板设计技术9.1 Protel99Se软件简介9.2 Protel99原理图 (SCH) 和印制电路板 (PCB) 设计9.2.1 设计电路板的基本过程9.2.2 简单电路原理图设计过程9.2.3 印制电路板 (PCB) 设计9.2.4 Protel存在的问题9.3 Protel常用元器件与练习题9.3.1 元件库9.3.2 练习题

<<电子工艺实训教材>>

编辑推荐

教育部门支持、权威专家指导，一流学校参与学术研究推动。

1理念创新：秉承“教学改革与学科创新引路，科技进步与教材创新同步”的理念，根据新时代对高职高专人才的需求，策划出版一系列体现教学改革最新理念，内容领先、思路创新、突出实训、成系配套的高职高专教材。

2方法创新：摒弃“借用教材、压缩内容”的滞后方法，专门开发符合高职特点的“对口教材”。

在对职业岗位（群）所需的专业知识和专项能力进行科学分析的基础上，引进国外先进的课程开发理论体系，坚持教材开发的四元结构（知名专家把关、教学一线教师编写、教研机构指导、行业用户参加），以确保符合职业教育的特色。

3特色创新：加大实训教材的开发力度，填补空白，突出热点，积极开发五年制高职教材和紧缺专业、热门专业、特色专业的教材。

对于部分教材，提供“课件”、“教学资源支持库”等立体化的教学支持，方便教师教学与学生学习。

对于部分专业，组织开发“双证教材”，注意将教材内容与职业资格、技能证书要求进行衔接。

4内容创新：在教材的编写过程中，力求反映应知识更新和科技发展的最新动态。

将新知识、新技术、新内容、新工艺、新案例及时反映到教材中来，更能体现高职专业设置紧密联系生产、建设、服务、管理一线的实际要求。

<<电子工艺实训教材>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>